

科学研究动态监测快报

信息科技专辑

INFORMATION TECHNOLOGY MONTHLY EXPRESS

2025
第4期

总第256期

本期视点

美智库深度分析美国及其盟友出口管制现状
台积电宣布斥资1000亿美元在美国新建五家工厂
日本内阁通过人工智能法案
Gartner发布2025年网络安全六大趋势预测
美NIST选定HQC作为第五个后量子加密算法
OpenAI组建NextGenAI联盟

中国科学院成都文献情报中心

CHENGDU LIBRARY AND INFORMATION CENTER, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

目 录

重点关注

[信息技术]美智库深度分析美国及其盟友出口管制现状1

科技政策与科研计划

[半导体]欧盟委员会投入 9.2 亿欧元支持建设半导体厂2

[半导体]台积电宣布斥资 1000 亿美元在美国新建五家工厂 .3

[信息技术]英国启动新的科技创新计划3

[人工智能]日本内阁通过人工智能法案4

[人工智能]美国国防部推出 Thunderforge 项目4

[网络安全]Gartner 发布 2025 年网络安全六大趋势预测5

[RISC-V]欧盟投资 2.4 亿欧元推进先进 RISC-V 处理器研发6

前沿研究动态

[量子技术]美 NIST 选定 HQC 作为第五个后量子加密算法..7

[半导体]国际团队研制出新型光子芯片放大器7

产业动态

[人工智能]OpenAI 组建 NextGenAI 联盟8

[量子技术]亚马逊首次推出其首款量子计算芯片 Ocelot.....9

[RISC-V]阿里巴巴达摩院推出玄铁 C930.....9

执行主编：唐川

执行编辑：黄茹

E-mail: tangc@clas.ac.cn

E-mail: huangr@clas.ac.cn

出版日期：2025 年 4 月 1 日

[信息技术]美智库深度分析美国及其盟友出口管制现状

2025年3月，美国战略与国际研究中心（CSIS）发布《理解美国及盟友实施人工智能和半导体出口管制的现行法律权力》报告，系统梳理了美国及其盟友出口管制体系的现状与演变趋势。

自2022年10月以来，美国投入了大量资源限制中国获得先进人工智能和半导体技术。然而，荷兰、德国、韩国、日本等国家和地区继续控制着人工智能和半导体价值链中的关键瓶颈，这使得单边行动不够有效。此外，现有的多边出口管制体系既不够灵活，也不够快速。

1、美国主要人工智能和半导体出口管制机构和相关工具

美国通过《出口管制改革法案（ECRA）》及《出口管制条例（EAR）》，结合相关行政命令，为国家安全领域提供强有力的工具，以精准控制军用、军民两用及纯商业物品与技术的出口、再出口、过境或转让。

美国出口管制制度划分了管理和执行军民两用商品和技术出口管制的责任。美国商务部工业与安全局（BIS）主要负责监管军民两用技术及较不敏感的军事物品，如先进半导体及相关技术的出口。美国国务院国防贸易管制局（DDTC）主要负责管制《国际武器贸易条例（ITAR）》所涵盖的武器和弹药，并对其进行监督。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）主要负责通过金融制裁对出口实施管制。

特朗普与拜登政府均致力于阻止中国获取关键人工智能技术，主要采取以下四种出口管制措施：一是商业管制清单（CCL），对特定商品、软件和技术实施限制；二是实体清单，针对特定参与者，限制其物项出口、再出口或转让；三是最终用途控制，对某些不受控制物品的最终用途施加限制；四是“美国人”管制规则，当服务中涉及的基础商品、软件和技术不受其他控制时，BIS通过行政令对公司或个人的活动进行限制。

2、协调盟友参与制裁行动

尽管美国盟国在先进人工智能芯片和半导体制造设备（SME）上利用制裁清单进行出口管制，但它们的出口管制措施相比美国商务部工业与安全局的限制较为薄弱。以荷兰和日本为例，尽管它们在与美国达成的三边协议中宣布了各自的管制清单，但它们的管制力度在以下三个重要方面仍弱于美国：荷兰和日本的管制范围相对较窄，未能涵盖所有敏感技术和产品；在执行出口管制时，荷兰和日本的力度和严格程度不及美国；两国在出口管制方面的法律框架和制度相对薄弱。

此外，荷兰和日本利用现有机构对先进半导体技术实施单边管制，但现有的制裁力度不够，究其原因这是由于美国外交协调不力还是盟友缺乏政治意愿，尚需进一

步探讨。但可以肯定的是，这一问题不能完全归咎于法律权威不足。

美国正积极推动与盟友协调出口管制政策，已开始绕过包含俄罗斯的传统多边机制，采用“多边减一”方式与盟友单独协调，这将增强联合行动有效性。虽然目前盟友已展开一系列合作，但CSIS报告强烈建议美国加强对盟友的外交压力，特别是韩国等仍未跟进美国限制措施的国家。报告认为，美国需增强对违规事件的处罚力度，并推动盟国提高执法力度，以促进更为统一的联盟行动。

黄茹 蒲云强 供稿自

<https://www.csis.org/analysis/understanding-us-allies-current-legal-authority-implement-ai-and-semiconductor-export>

原文标题：understanding-us-allies-current-legal-authority-implement-ai-and-semiconductor-export

科技政策与科研计划

[半导体]欧盟委员会投入 9.2 亿欧元支持建设半导体厂

2025年2月20日，欧盟委员会批准了9.2亿欧元的德国援助措施，用于在德累斯顿建造一座新的半导体制造厂。

该工厂将由英飞凌公司运营，专注于研发两大关键产品：一是用于电子系统中电源开关、管理和控制的分立功率器件；二是模拟/混合信号的集成电路。这座工厂将是欧洲首家能在保持高产能的同时，在两大类产品之间实现快速切换生产的工厂。

作为一座前端设施工厂，该工厂将涵盖晶圆加工、测试和分离等环节，生产的半导体产品将广泛应用于工业、汽车和消费领域。预计到2031年，该工厂将实现满负荷生产，为欧洲半导体产业注入强劲动力。

为支持这一重大项目，英飞凌公司将获得一笔高达9.2亿欧元的直接资助，以助力其总额为35亿欧元的投资计划。作为获得资助的条件，英飞凌公司承诺将采取一系列措施，以确保该项目对欧盟半导体价值链产生更广泛的积极影响：在欧洲投资下一代芯片的研发，推动技术进步和创新；根据《欧洲芯片法案》规定，在供应短缺的情况下为应对芯片危机做好准备；向中小企业和研究机构提供新设施的访问权，支持它们进行测试和原型设计，促进产学研合作。

黄茹 供稿自

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_557

原文标题：Commission approves €920 million German State aid measure to support Infineon in setting up a new semiconductor manufacturing facility

[半导体]台积电宣布斥资 1000 亿美元在美国新建五家工厂

2025年3月4日，美国总统特朗普与台积电首席执行官共同宣布，台积电将向其位于亚利桑那州的半导体芯片制造业务投资1000亿美元，这是美国史上最大的外国直接投资。

台积电表示，该笔资金将用于扩建计划，具体包括建立三个新的芯片制造厂、两个先进的封装设施和一个主要的研发中心。扩建计划是加强台积电在美国芯片制造的历史性举措。随着全球各行各业都面临芯片短缺的问题，台积电的新制造部门将为各行各业提供芯片供应。

这项1000亿美元的投资旨在提高美国国内半导体生产能力，并减少美国对亚洲的依赖。台积电在美国的扩建计划将对美国经济产生重大积极影响。虽然台积电尚未具体说明新投资的具体时间表，但预计将在未来四年内创造40000个工作岗位。

据报道，台积电首席执行官与特朗普的会面有助于达成这笔交易。此外，台积电与英伟达和AMD等美国公司的合作伙伴关系进一步巩固了美国成为半导体创新领导者的目标。

黄茹 供稿自

<https://techresearchonline.com/news/trump-tsmc-us-chip-manufacturing/>

原文标题: Trump and TSMC Announce \$100 Billion Plan to Strengthen US Chip Manufacturing

[信息技术]英国启动新的科技创新计划

据英国科学创新与技术部2025年3月10日消息，英国科学创新与技术部部长在英国科技会议上宣布启动新的科技创新计划，加快英国技术创新。

该计划具体包括：成立监管创新办公室，并任命威利茨担任首任主席；启动数字和技术领域的专项计划；制定透明、有利于创新的新法规，消除“繁文缛节”；向Innovate UK量子任务试点项目投资1200英镑；投资2300万英镑用于前沿电信研究和部署；彻底改革公共部门为人工智能实验和其他数字项目提供资金的方式，减少资金浪费；启动市场参与，寻找足够的公私合作伙伴关系等，力争到2030年实现人工智能研究资源在现有基础上增加20倍。

黄茹 供稿自

<https://www.gov.uk/government/news/technology-secretary-kickstarts-plan-to-bin-barriers-and-back-innovators-to-reap-rewards-of-new-tech-over-next-decade-and-drive-plan-for-change>

原文标题: Technology Secretary kickstarts plan to bin barriers and back innovators to reap rewards of new tech over next decade and drive Plan for Change

[人工智能]日本内阁通过人工智能法案

2025年2月28日，日本内阁通过《人工智能相关技术的研发及应用促进法》草案。该法案是日本政府为应对人工智能技术快速发展而制定的综合性法律框架，旨在通过系统化的政策推动人工智能技术的研究、开发和应用，确保日本在这一领域的国际竞争力。

该法案将人工智能技术视为日本经济社会发展的基础技术，强调通过相关技术的研发和应用，提升行政效率，推动新产业发展，提高国民生活水平。法案重点关注人工智能技术的潜在风险，强调提升研发及应用过程的透明度，以防止技术滥用导致犯罪、侵犯隐私或著作权等不当行为。法案还强调日本应在人工智能领域保持研发能力，并通过推进国际合作提升相关产业的国际竞争力，确保日本在全球科技竞争中的领先地位。

法案清晰界定了国家、地方政府、研究机构、企业及国民在人工智能技术研发与应用中的职责分工，提出了包括研发、人才培养、普及教育和国际合作等多项基本政策，以全面助力人工智能技术健康发展。法案还提出在内阁设立人工智能战略总部，负责人工智能相关技术研发及应用战略规划的制定及协调。

值得注意的是，为避免过度监管，法案未设惩罚性条款，而是鼓励企业自主提升人工智能运用中的安全性和透明度。但法案也提到如果人工智能技术的使用损害了国民权利，将公布涉事企业名单，增强对侵犯人权行为的威慑。

唐衢 供稿自

<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA262EF0W5A220C2000000/?msocid=130e4868aacc698>

f0e315d55ab8268f2

原文标题：AI（人工知能）技術の研究開発・活用推進法案の要旨

[人工智能]美国国防部推出 Thunderforge 项目

2025年3月5日，美国国防部与 Scale AI 公司签署了一项合作协议，启动 Thunderforge 项目。该项目旨在利用人工智能技术，加强军事规划和决策支持系统，以提升作战效率和战略决策能力。

Thunderforge 项目由美国国防创新部门（DIU）牵头，目标是通过人工智能驱动的模拟和决策建议来增强运营和战略分析能力。该项目致力于将人工智能技术整合进军事行动和战区规划流程，并结合先进的建模与仿真技术。最终，该系统将实现决策过程的加速，使得规划人员能够迅速处理大量信息，生成多样化的行动方案，并通过人工智能驱动的兵棋推演来预测和应对不断变化的威胁。

当前军事规划流程所依赖的技术和方法已显陈旧，与现代战争的速度和所需的

响应能力之间存在显著差距。Thunderforge 项目开发的技术解决方案旨在填补这一鸿沟，提供人工智能辅助的规划功能、决策支持工具和自动化工作流程，使军事规划者能够有效应对动态变化的作战环境。通过整合先进的大型语言模型（LLM）、人工智能驱动的模拟和基于代理的交互式兵棋推演，Thunderforge 将重塑美国军队的行动准备和执行方式。

系统初期将部署于美国印太司令部（INDOPACOM）和美国欧洲司令部（EUCOM），以支持关键的军事规划任务，包括战役开发、战区资源分配和战略评估。Thunderforge 标志着美国军队向人工智能驱动、数据驱动战争模式的重要转变，确保能够迅速而精确地预测并应对各种威胁。初始部署完成后，Thunderforge 将进一步扩展至其他战斗指挥部。

作为下一代人工智能驱动的军事决策支持系统，Thunderforge 增强了联合部队以机器速度进行规划、适应和应对新挑战的能力，助力作战人员预防重大冲突或在必要时取得胜利。系统将集成 Scale AI 的代理应用程序和 GenAI 的测试评估专长，以及 Anduril 的 Lattice 软件平台和 Microsoft 支持的先进 LLM。Thunderforge 团队将打造一个统一的规划生态系统，人工智能代理可在其中模拟兵棋推演和规划场景，优化行动方案。

黄茹 供稿自

<https://www.diu.mil/latest/dius-thunderforge-project-to-integrate-commercial-ai-powered-decision-making>

原文标题：Pentagon Taps AI for Military Planning With Thunderforge Project

[网络安全]Gartner 发布 2025 年网络安全六大趋势预测

2025年3月3日，国际咨询机构Gartner发布了2025年六大网络安全趋势预测。这些趋势受到生成式人工智能的发展、数字去中心化、供应链相互依赖性、法规变更、长期人才短缺以及不断演变的威胁形势的共同影响。

（1）生成式人工智能推动数据安全策略改变

长期以来，企业的安全投入和资金主要集中在保护结构化数据（如数据库）上。然而，随着生成式人工智能的兴起，数据安全策略正逐步向保护文本、图像和视频等非结构化数据倾斜。

（2）机器身份管理重要性日益凸显

随着生成式人工智能、云计算、自动化技术的广泛应用，机器账号和凭据在物理设备与软件工作负载中的使用大幅增长。如果不加以控制和管理，机器身份可能会显著扩大企业的被攻击面。Gartner指出，企业必须制定强有力的机器身份与访问

管理（IAM）策略，以防范潜在攻击。

（3）人工智能实际应用效应正日益成为关注焦点

安全与风险管理领导者在人工智能实施方面成效参差不齐。将人工智能融入现有安全与风险管理计划，与现有技术相结合，将有助于提高人工智能实际应用效应。

（4）网络安全技术持续优化

根据Gartner调查，安全与风险管理领导者需优化其工具集，以构建更高效、更具成效的安全计划。Gartner建议，安全与风险管理领导者在采购决策、安全架构设计、安全工程实施和其他利益相关方需求之间寻求平衡，以维持最优的安全态势。因此，安全与风险管理领导者应整合和验证核心安全管理措施，提升数据的可移植性，同时强化威胁建模和人工智能采用等技术在安全需求评估中的应用。

（5）安全行为与文化计划价值将不断增强

部分安全与风险管理领导者已充分认识到安全行为与文化计划（SBCP）在提升网络安全防护能力方面的价值。Gartner预测，到2026年，整合生成式人工智能与SBCP的解决方法，将使企业因员工操作失误导致的网络安全事件发生率降低40%。

（6）网络安全“倦怠”应得到充分关注

在本就面临着技能人才短缺的网络安全行业中，安全与风险管理领导者及其团队的“倦怠”问题已成为制约行业发展的关键瓶颈。这种“倦怠”主要源于快速演变的威胁态势、日益严格的法规要求以及不断变化的业务环境所带来的持续高压。与此同时，安全团队往往面临权限不足、高层支持有限以及资源配置匮乏等困境，进一步加剧了这一挑战。

唐衢 供稿自

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-03-03-gartner-identifiesthe-top-cybersecurity-trends-for-2025>

原文标题：Gartner Identifies the Top Cybersecurity Trends for 2025

[RICV-V]欧盟投资 2.4 亿欧元推进先进 RISC-V 处理器研发

2025年3月7日，欧盟的DARE SGA1项目正式启动第一阶段计划，将投资2.4亿欧元，以提升欧洲在高性能计算和人工智能领域的技术自主性。

该项目由欧洲高性能计算联合企业（EuroHPC JU）资助，由巴塞罗那超级计算中心（BSC-CNS）协调，联合38个合作伙伴开发下一代欧洲处理器和计算系统，并优化软件生态系统。该项目的合作伙伴还有意大利高性能计算、大数据和量子计算研究中心、都灵大学、比萨大学、罗马第一大学、都灵和米兰理工学院、里雅斯特国际高等研究院（SISSA）、意大利国家核物理研究所（INFN）。

DARE SGA1项目长达6年，重点是开发三款RISC-V小芯片：一是矢量加速器（VEC），由Openchip领导，用于HPC-AI融合；二是人工智能处理单元（AIPU），由Axelera AI领导，专注人工智能推理加速；三是通用处理器（GPP），由Codalip领导，优化欧洲超级计算机的高性能计算负载。这些小芯片将在先进技术节点中开发和流片，通过提供更高的效率、可扩展性和成本优势来克服传统单芯片的局限性。

DARE SGA1项目将采纳硬件与软件协同设计策略，以一系列精选的高性能计算和人工智能应用为开发导向，同步推进针对硬件优化的完整软件栈构建与硬件设计，充分利用RISC-V硬件的早期仿真和模拟资源。此外，DARE项目还将制定一个路线图，为未来超级计算机的部署开展可扩展性研究。

黄茹 供稿自

<https://www.supercomputing-icsc.it/en/2025/03/07/europe-takes-a-major-step-towards-digital-autonomy-in-hpc-and-ai-with-the-launch-of-dare-sga1project/>

原文标题：EUROPE TAKES A MAJOR STEP TOWARDS DIGITAL AUTONOMY IN HPC AND AI WITH THE LAUNCH OF DARE SGA1PROJECT

前沿研究动态

[量子技术]美 NIST 选定 HQC 作为第五个后量子加密算法

2025年3月11日，美国国家标准与技术研究院（NIST）选定了一种名为HQC的后量子加密新算法，该算法将作为主加密算法ML-KEMML-KEM的备份。

此前，NIST在2024年推出了基于ML-KEM的抗量子加密标准。HQC算法的作用是在量子计算机未来可能破解ML-KEM的情况下，提供额外的安全保障。这两种算法的目标是确存储和公共网络传输数据的安全。

传统加密算法基于复杂的数学问题，而量子计算机有能力迅速筛选出这些问题的潜在解决方案，从而威胁现有加密技术。ML-KEM基于结构化网格的数学概念，而HQC则基于纠错码原理，其算法长度较长，因此需要的计算资源更多。

黄茹 供稿自

<https://www.nist.gov/news-events/news/2025/03/nist-selects-hqc-fifth-algorithm-post-quantum-encryption>

原文标题：NIST Selects HQC as Fifth Algorithm for Post-Quantum Encryption

[半导体]国际团队研制出新型光子芯片放大器

2025年3月18日，瑞士洛桑联邦理工学院与IBM欧洲研究院联合团队研制出一款

基于光子芯片的行波参量放大器，通过紧凑结构实现了超带宽信号放大，相关研究成果发表在《自然》期刊上。

该放大器采用了将磷化镓沉积在二氧化硅上的技术。磷化镓是一种具有优异光学特性的III-V族化合物半导体材料，表现出强烈的光学非线性，使通过其中的光波能以增强信号强度的方式相互作用。其次，它的折射率高，可将光紧密限制在波导内，显著提高放大效率。基于此，研究团队使用几厘米长的波导实现了高增益，使放大器的体积大幅缩小，且所有功能都集成在一个紧凑的芯片级设备中。

这款芯片级放大器在约140纳米的带宽范围内实现了超过10分贝的净增益，是传统掺铒光纤放大器带宽的3倍。此外，该器件在保持较低噪声的同时，增益可达35分贝，并能处理输入功率范围跨越6个数量级的信号，使该放大器在电信之外的各种应用中具有高度适应性，例如精密传感。此外，这款放大器还提升了光学频率梳和相干通信信号的性能。

黄茹 供稿自

<https://paper.sciencenet.cn/htmlnews/2025/3/540621.shtm>

原文标题：光子芯片放大器传输数据带宽提升3倍

产业动态

[人工智能]OpenAI 组建 NextGenAI 联盟

2025年3月4日，OpenAI宣布启动NextGenAI联盟，集结了15所顶尖研究机构，旨在利用人工智能加速研究突破，革新教育模式。OpenAI承诺投入5000万美元，为该联盟提供研究资助、计算资源和应用程序编程接口（API）访问权限，支持人工智能创新。

OpenAI通过为联盟参与机构提供资金和资源来推动关键创新，促进人工智能人才培养。NextGenAI联盟的成立将进一步加强学术界和产业界之间的合作。

俄亥俄州立大学将开展人工智能在数字健康、先进疗法、制造业等领域的应用研究，并探索人工智能在创新教学模式中的应用。哈佛大学和波士顿儿童医院将合作展开人工智能在罕见病诊断方面的研究。杜克大学将利用人工智能开创元科学研究，探索人工智能最佳应用领域。

德州农工大学将推出生成式人工智能素养计划，通过系统化实践培训，全面提升师生在学术场景中负责任使用人工智能的能力。麻省理工学院将重复利用OpenAI提供的计算资源和API接口，开展人工智能模型训练与微调项目，着力培养具备实战经验的下一代人工智能领军人才。

牛津大学将全面推进人工智能技术在教育创新和校务管理中的应用，并借助

OpenAI API接口加速博德利图书馆珍贵文献的数字化转录进程，提升学术资源可及性。密西西比大学将积极探索人工智能赋能教育、科研与服务的新模式，开发人工智能驱动的创新解决方案，服务师生及更广泛社区。波士顿公共图书馆将依托人工智能技术推进公共领域资料的数字化建设，优化信息检索系统，为多元化读者群体提供更便捷的知识获取途径。

唐蘅 黄茹 供稿自

<https://openai.com/index/introducing-nextgenai/>

原文标题: Introducing NextGenAI: A consortium to advance research and education with AI

[量子技术]亚马逊首次推出其首款量子计算芯片 Ocelot

2025年2月27日，亚马逊网络服务公司(AWS)推出了其首款量子计算芯片Ocelot，标志着AWS在量子计算领域取得重大进展。

该芯片由AWS与加州理工学院合作开发，可将与量子纠错相关的成本降低多达90%。Ocelot芯片架构使用了一种新的设计，从头开始构建纠错功能，并使用猫量子比特，减少所需的物理量子比特。

芯片由两块面积为1平方毫米的硅微芯片组成，内部配置了5个数据量子比特和5个用于稳定数据量子比特的“缓冲电路”，以及4个用于量子纠错的附加量子比特。Ocelot的高质量振荡器由一种称为钽的超导材料薄膜制成，AWS材料科学家开发了一种在硅芯片上处理钽的特定方法，以提高振荡器的性能。该芯片的设计不仅提升了量子计算机的可靠性，还大幅降低了构建成本。

黄茹 供稿自

<https://www.aboutamazon.com/news/aws/quantum-computing-aws-ocelot-chip>

[https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/amazon-unveils-quantum-chip-aiming-](https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/amazon-unveils-quantum-chip-aiming-shave-years-off-development-time-2025-02-27/)

[shave-years-off-development-time-2025-02-27/](https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/amazon-unveils-quantum-chip-aiming-shave-years-off-development-time-2025-02-27/)

原文标题: Amazon Web Services announces a new quantum computing chip

[RISC-V]阿里巴巴达摩院推出玄铁 C930

2025年2月28日，阿里巴巴达摩院举办的2025玄铁RISC-V生态大会在北京举行，达摩院宣布其首款服务器级CPU C930将在3月开启交付。

C930在SPECint2006基准测试中达到了15/GHz的优异性能，适用于服务器级别的高性能应用。C930不仅融合了512 bits RVV1.0和8 TOPS Matrix双引擎，实现了通用计算与人工智能计算的原生结合，还提供了DSA扩展接口，以支持更多要求。

此外，达摩院还公布了玄铁处理器家族的新成员研发计划，包括C908X、R908A和XL200，分别针对人工智能加速、车载应用和高速互联等方向进行优化。C908X作为玄铁系列的首款人工智能专用处理器，支持4096 bits的超长数据位宽RVV1.0矢量扩展。R908A则专为车规级芯片的高可靠性需求设计，而XL200则将提供更大规模、更高效的多簇一致性互联能力。

为更好地支持玄铁处理器的功能扩展，达摩院还基于Linux、Android和RTOS三套主流操作系统，推出了相应的玄铁SDK。其中，玄铁Linux SDK包含了Hypervisor虚拟化、CoVE安全框架、玄铁人工智能框架以及高性能算子库等丰富的子系统，旨在助力RISC-V在高端性能和人工智能领域的开发。

黄茹 供稿自

<https://www.cryptopolitan.com/alibaba-risc-v-processor-ai/>

原文标题：Alibaba launches RISC-V processor to boost AI capabilities

版权及合理使用声明

《科学研究动态监测快报》（以下简称《监测快报》）是由中国科学院文献情报中心、中国科学院成都文献情报中心、中国科学院武汉文献情报中心以及中国科学院兰州文献情报中心和中国科学院上海生命科学信息中心按照主要科学研究领域分工编辑的科学研究进展动态监测报道类信息快报。

《监测快报》遵守国家知识产权法的规定，保护知识产权，保障著作权人的合法权益，并要求参阅人员及研究人员遵守中国版权法的有关规定，严禁将《监测快报》用于任何商业或其他营利性用途。读者在个人学习、研究目的中使用信息报道稿件，应注明版权信息和信息来源。未经编辑单位允许，有关单位和用户不能以任何方式全辑转载、链接或发布相关科学领域专辑《监测快报》内容。有关用户单位要链接、整期发布或转载相关学科领域专辑《监测快报》内容，应向具体编辑单位发送正式的需求函，说明其用途，征得同意，并与具体编辑单位签订服务协议。

欢迎对《科学研究动态监测快报》提出意见与建议。

信息科技专辑：

编辑出版：中国科学院成都文献情报中心

联系地址：四川省成都市天府新区群贤南街 289 号（610299）

电话：（028）85235556

电子邮件：casit@clas.ac.cn

内部资料

中国科学院成都文献情报中心

新一代信息科技战略研究中心

电话：028-85235075

E-mail: casit@clas.ac.cn

地址：四川省成都市群贤南街289号, 610299